

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2021 年 12 月 1 日投资者关系活动记录表

编号：2021-12-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	平安资产管理有限责任公司：叶子昂、周琳、傅一帆、龚彦恺、陆保、 罗洁筠、陆禹坤 国盛证券：谈祺阳
时间	10：20~11:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司历史介绍</p> <p>公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 Harbor 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板，公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户升级。自 2018 年起公司开始步入产能扩张阶段，前期投资产能正逐步释放。</p> <p>随着产能的逐步释放及经营效率的逐步提升，公司营收保持稳健增</p>

长，持续盈利；同时，产品结构、经营模式的差异使得公司具备一定的议价能力，毛利率处于同行较高水平。

未来公司的重点工作是推动广州兴科项目 IC 封装基板业务的投资扩产。

二、公司半导体业务介绍

公司半导体业务主要包括半导体测试板及 IC 封装基板，情况如下：

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 Harbor、广州科技。Harbor 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

2021 年上半年半导体测试板实现销售收入 2.03 亿元。2021 年上半年测试板收入同比下滑主要是因为出售上海泽丰股权导致其不再纳入合并报表，美国 Harbor 产能受限，以及国内扩产的半导体测试板产能尚未形成增量贡献。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已处于满产状态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成厂房建设，处于装修和产线设备安装阶段。

三、IC 封装基板业务介绍

半导体行业从 2020 年开始表现出产销两旺的格局，收入、利润持续增长，产业链景气度高。公司从 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现预设经营目标。

2020 年全球 IC 封装基板行业规模 100 亿美金，增长 25%；Prismark 预测 2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元，复合增长率预期为 9.7%，届时 IC 封装基板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。2020

年内资载板厂规模为 4 亿元美金，全球市场占有率仅为 4%，而国内封测厂全球市场占有率为 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产是 IC 封装基板行业需求增长的保证，受益于芯片产业链的高景气，公司目前 IC 封装基板订单能见度高。

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家，行业赛道好，玩家少。三星认证的通过说明了我们的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可，且海外大客户的认证周期都是长达 2 年以上，因此预计未来 2~3 年新进入者仍无法成长到足以与公司比肩，产业链供需格局预期仍乐观。

四、公司客户情况介绍

公司经过二十多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，在样板行业成功树立了多品种、小批量、快速交付的品牌形象，具有一定的品牌效应。公司 2010 年上市前合作客户有 2,000 多家，目前活跃客户超过 4,000 家。公司客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，客户所涉行业较广，不依赖单一行业、单一客户，受下游客户单一行业周期、经济周期影响小。

五、公司 IC 封装基板的优势

公司 IC 封装基板主要下游应用为存储类载板，营收占比约三分之二，与目前国内可实现载板量产的其余两家友商深南电路、珠海越亚专注的领域均不同，存储类载板是公司 2012 年就瞄准的目标市场，是 BT 类载板最大的应用领域，需求量最大，且下游国内厂商正在积极扩产，是未来主要增量市场所在。从规模看，目前深南电路规模最大，随着深南电路及珠海越亚开始涉足存储类载板，未来公司与其会有竞争，但竞争格局相对仍较好。

六、PCB 和半导体业务营业收入占比情况

2021 年上半年公司 PCB 业务占总销售收入的比重为 75.49%，半导体业务占总销售收入的比重为 21.04%，目前 PCB 业务仍为公司利润的主要

	<p>来源。未来 PCB 业务增速会保持平稳增长，半导体业务中 IC 封装基板增速相对 PCB 业务会更快一些，主要是因为下游需求增速快。</p> <p>七、下游应用领域未来景气度介绍</p> <p>从产品结构看，呈现结构分化的增长趋势：高端产品的景气度较高，中低端产品随着产品更新迭代，技术升级，需求会相对弱一些。从应用领域看，通信行业的增长情况取决于 5G 推动的进度；安防、工控、轨道交通等行业的增长相对平稳；医疗方面目前虽因疫情影响市场景气度较好，但从长期看表现平稳；汽车电子方面，总量没有大的增长，结构会从传统汽车转向新能源汽车。</p> <p>八、定增项目目前进度介绍</p> <p>定增价格和定增对象将通过询价的方式确定，具体的发行时间有待与投行团队沟通之后确认。</p>
附件清单	无
日期	12 月 1 日